



*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen.
 printed circuit board layout, components side view
 modèle de la carte imprimée, vue du côté à équiper

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Mindestmenge Lowest quantity Quantité minimale
P 137 S	8	38	

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).
 The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).
 L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférentielles (**gras**).

P 137 S

Modular-Einbaukupplung, 8p8c (RJ45), mit Schirmung, abgewinkelte Ausführung, mit Flansch, für Leiterplatten

1. Werkstoffe

Kontaktträger	PBT GF, V0 nach UL 94
Kontakt	Cu-Legierung, unternickelt und selektiv vergoldet
Lötkontakt	Cu-Legierung, unternickelt und verzinkt
Gehäuse	PBT GF, V0 nach UL 94
Schirmung	Cu-Legierung, verzinkt

2. Mechanische Daten

Kontaktierung mit	Modularstecker P 129
-------------------	----------------------

P 137 S

Modular chassis socket, 8p8c (RJ45), with shielding, angular version, with flange, for printed circuit boards

1. Materials

Body	PBT GF, V0 acc. to UL 94
Contact	Cu alloy, pre-nickeled and selectively gilded
Solder contact	Cu alloy, pre-nickeled and tinned
Housing	PBT GF, V0 acc. to UL 94
Shielding	Cu alloy, tinned

2. Mechanical data

Mating with	modular plug P 129
-------------	--------------------

P 137 S

Embase femelle modulaire, 8p8c (RJ45), avec blindage, version angulaire, avec collet, pour cartes imprimées

1. Matériaux

Corps isolant	PBT GF, V0 suivant UL 94
Contact	Cu alliage, sous-nickelé et doré sélectivement
Contact à souder	Cu alliage, sous-nickelé et étamé
Boîtier	PBT GF, V0 suivant UL 94
Blindage	Cu alliage, étamé

2. Caractéristiques mécaniques

Raccordement avec	connecteur modulaire mâle P 129
-------------------	---------------------------------